



nepes

# 2021 纳沛斯集团简介



Semiconductor | Neuromorphic AI | IT Materials | Energy | 2<sup>nd</sup>ary battery



关于纳沛斯



事业领域



核心技术



国际化纳沛斯



企业文化

HYPER  
CONNECTING  
TECHNOLOGY



纳沛斯在决定公司名称的那一刻就开始了4D管理



词源(希伯来语)

חיי נצח (khai nepes)

永恒的生命 / 精力充沛

长寿企业



## 什么是 4D (4th dimension) 管理?

为了让公司能成为有丰盛收获的长寿企业，  
使**创造、创新、创拓**事宜和**有趣、满足、快乐**事宜  
不断发生的经营管理。

Corporate Identity



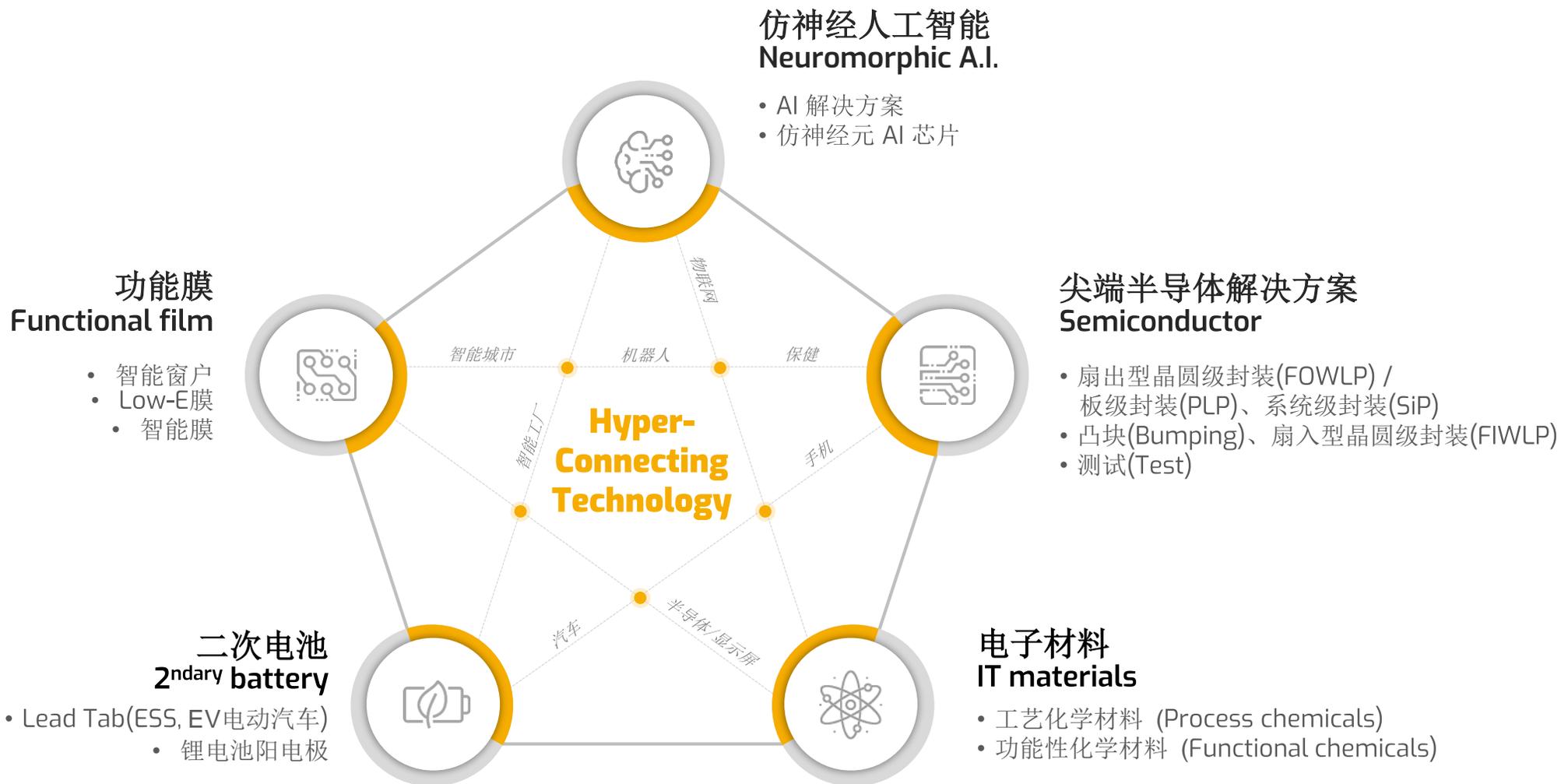
Trademark



公 司 名	株式会社 纳沛斯
公司成立日	1990年 12月
公司上市日	1999年 12月 (KOSDAQ 033640)
集团董事长	李柄九 (Byung-Koo Lee) 先生
海 外 法 人	中国、美国、菲律宾, 印度尼西亚, 俄罗斯



## 纳沛斯创造连接未来事业的超链接技术 (Hyper-connecting Technology)





### 产品及服务

- 工厂用AI解决方案
- 视觉用AI解决方案
- 监控用AI解决方案
- 仿神经元AI芯片

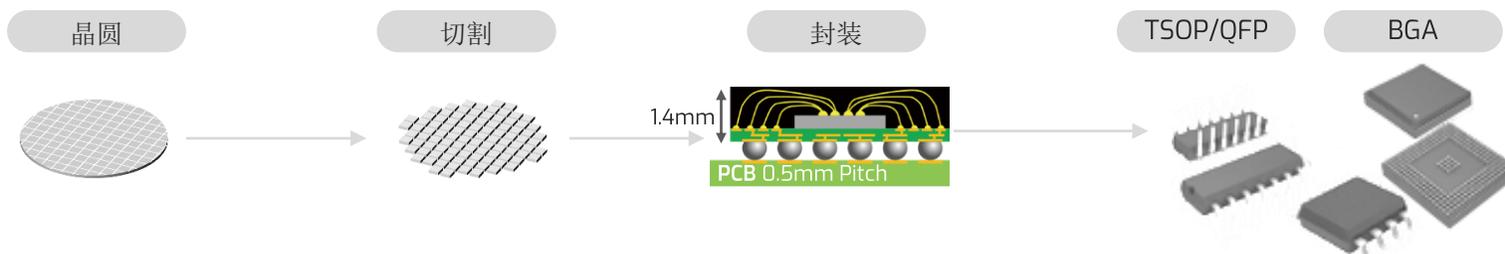




超高性能及更小巧轻薄的 **End FAB** 解决方案



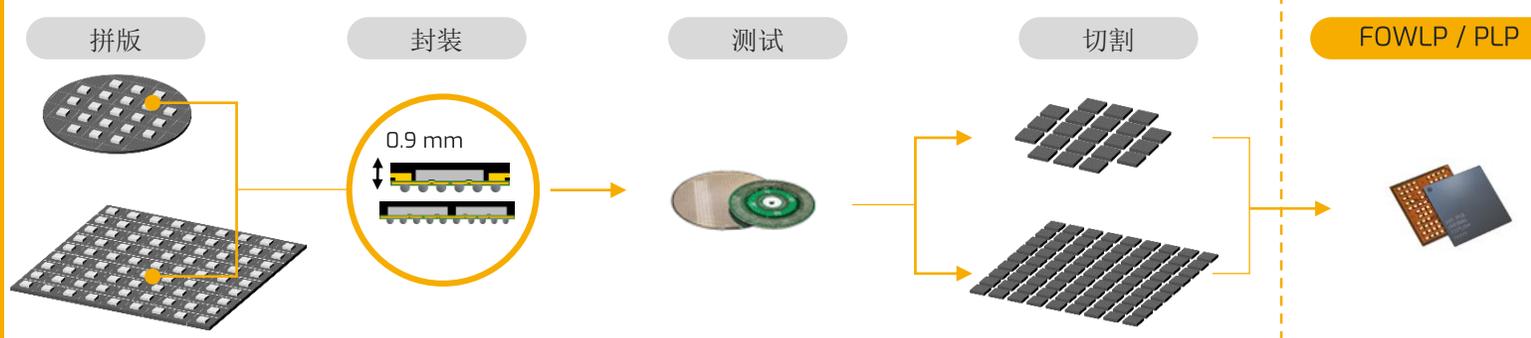
传统封装



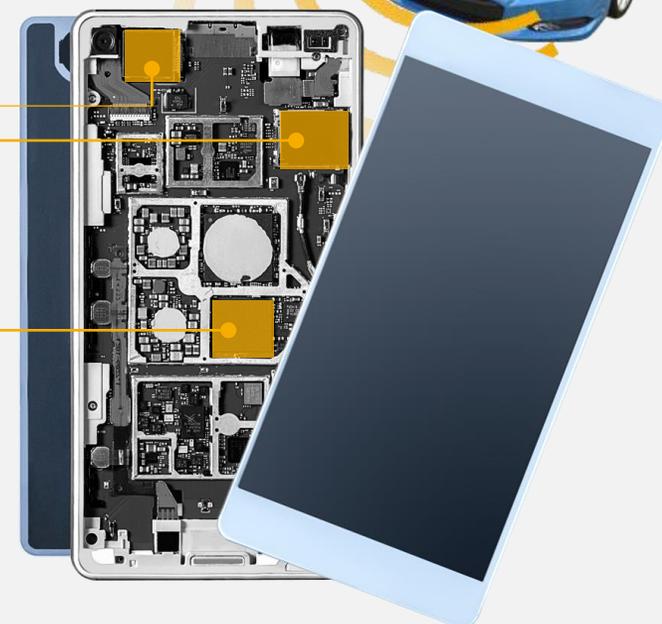
晶圆级封装 WLP



FOWLP / PLP



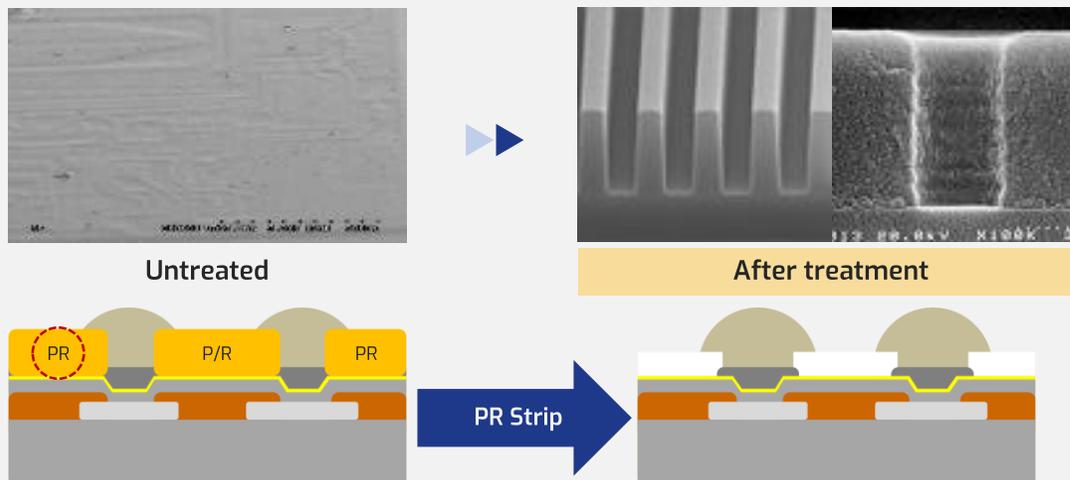
应用产品





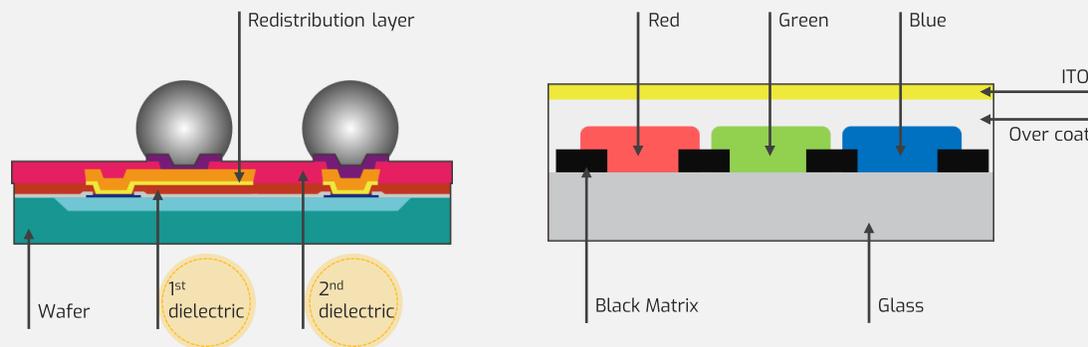
### Process chemical

- PR
- 显影液 (Developer)
- PSPI Developer
- 剥离剂 (Stripper)
- 蚀刻剂 (Etchant)
- HSN
- PV texture



### Functional chemical

- ILD
- 铜镀液 (Cu Plating)
- Color paste



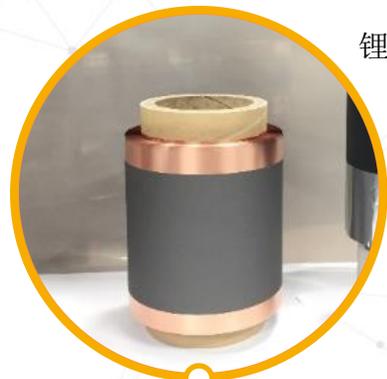
### 应用产品



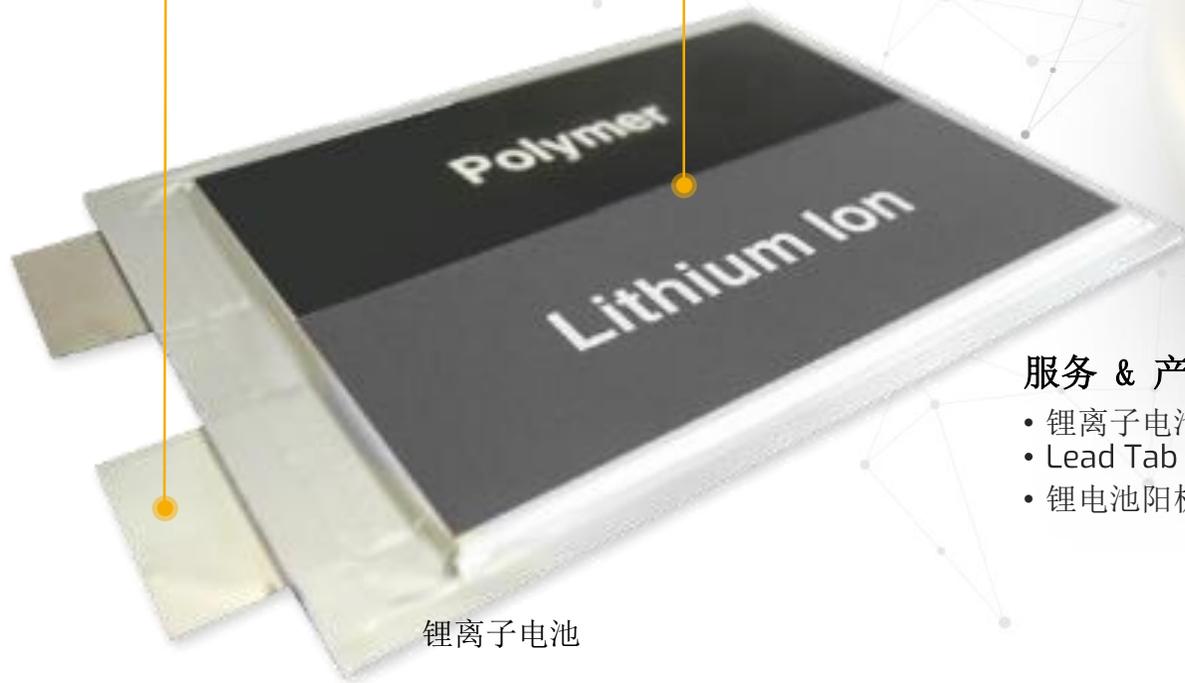
半导体  
显示屏(LCD, OLED)  
太阳能电池



Lead Tab



锂电池阳极



锂离子电池

### 服务 & 产品

- 锂离子电池
- Lead Tab
- 锂电池阳极电极

### 应用范围



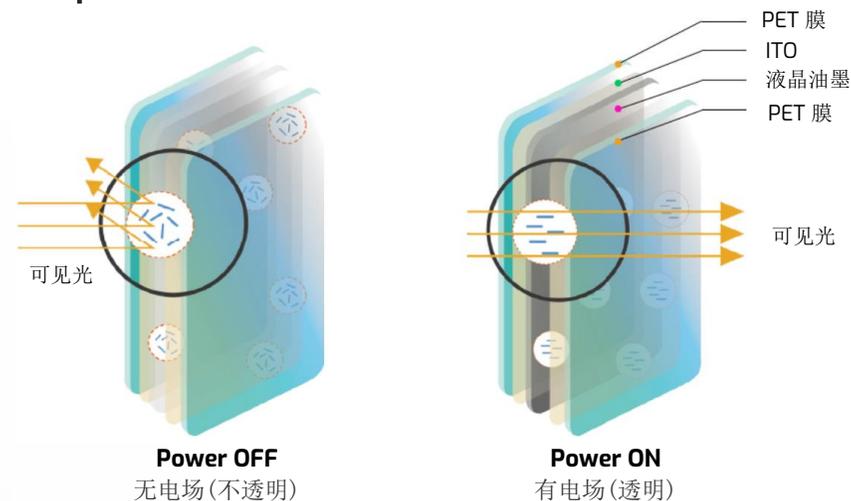


变色膜 (Super LC)



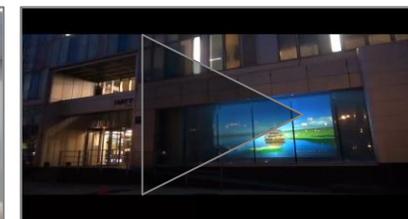
Low-E膜 (Pentix®)

Super LC的结构及原理



服务 & 产品

- Smart Windows (on/off)
- Low-E film (Pentix50, Pentix60)





调光眼镜膜

服务 & 产品

- 智能墨镜
- AR/VR眼镜
- 可切换型镜子
- 汽车用产品

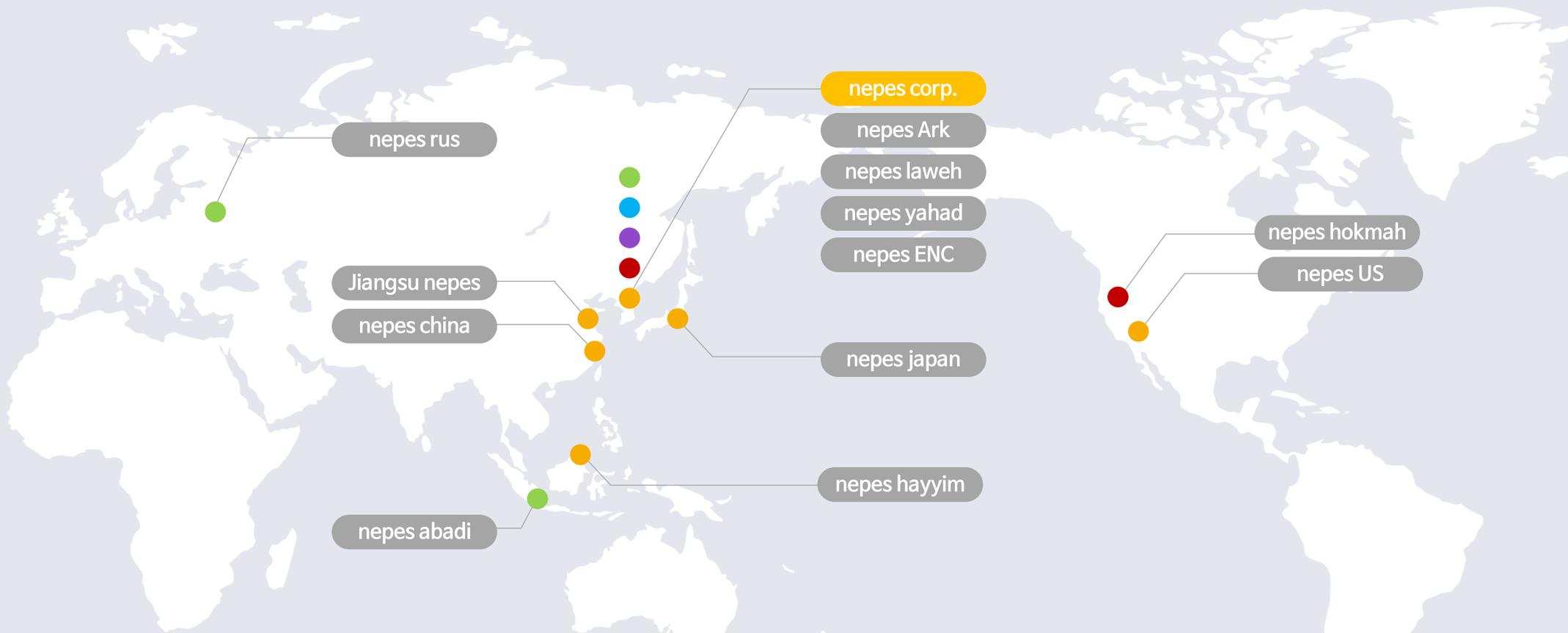




# 国际化纳沛斯



将我们的技术和产品服务于世界各地。



- Semiconductor
- Energy
- IT materials
- Neuromorphic A.I
- 2<sup>nd</sup>ary battery



# 企业文化

纳沛斯以企业文化为基础创造业绩来持续成长



Global  
**NO.1**  
企业文化



# 3.3.7 LIFE



**nepes**  
nepes corporation

感谢！

To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Psalm 136:4

\* A dandelion means 'Gratitude' in the language of flowers

**nepes corporation**

2415, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

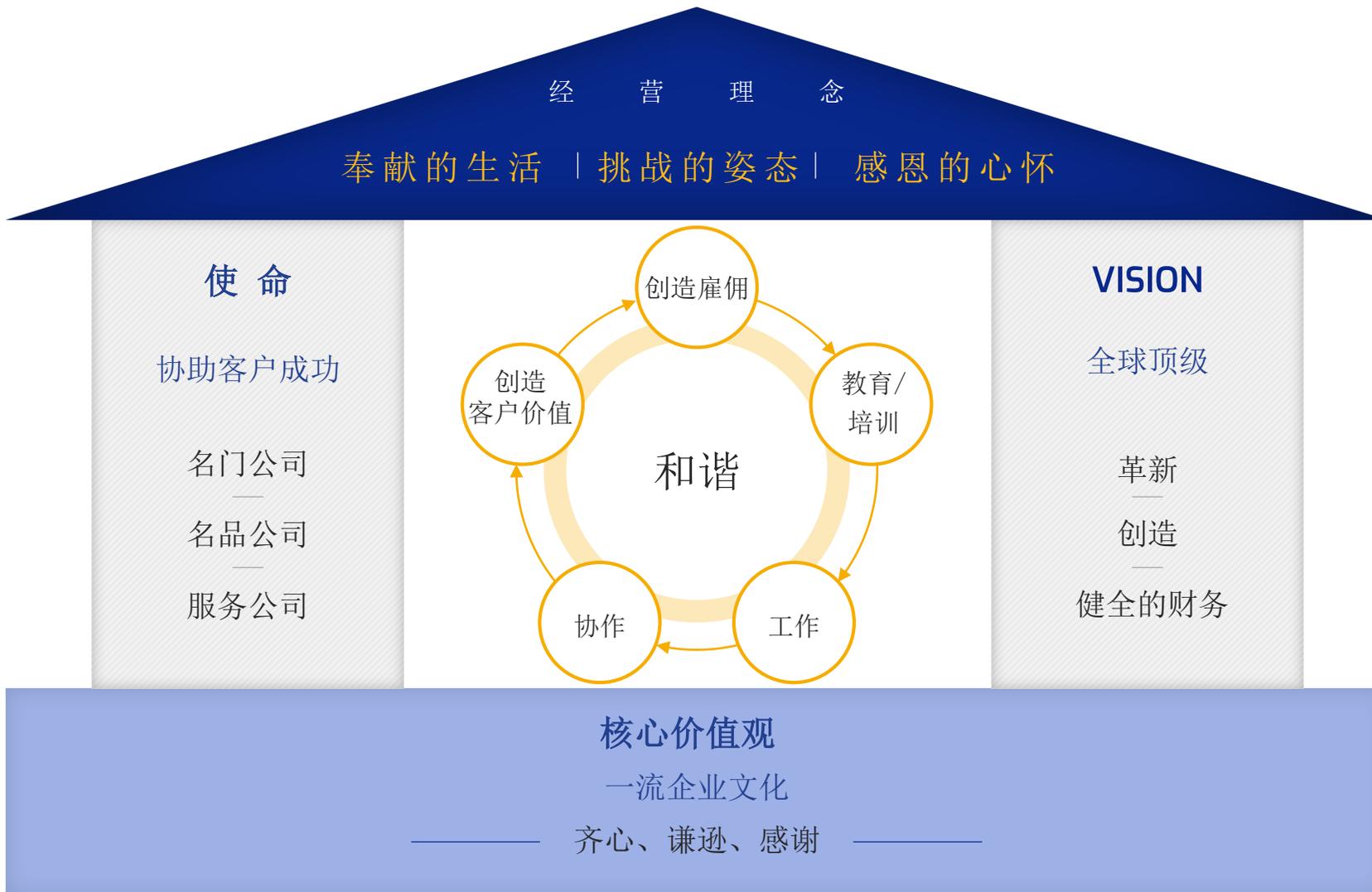
Tel : 02-3470-2700

Fax : 02-3470-2708

URL : [www.nepes.co.kr](http://www.nepes.co.kr)



纳沛斯是以一贯性的实践来实现 **经营理念** 的企业





纳沛斯是 **优秀人才集合在一起的共同体。**



nepes LOGO



‘以感谢联接的n家族共同体’

固有的问候语

**superstar**

‘superstar’ 是尊重对方  
纳沛斯固有的尊称招呼语

市场趋势

小型规格  
(基于晶圆级平台)

高集成度晶圆级系统封装

技术路标规划

**Conventional PKG**

1.4mm

Chip

QFP

QFN

FCBGA

**Bumping**

Gold

Solder

Etc(Cu Pillar, CNA bumping)

**WLP**

8"WLP

12"WLP

Chip 0.4mm

**Fan-out WLP/PLP**

nPLP™

600x600mm

Chip 0.9mm

**System in PKG**

Multi-Chip Packaging

Si GaAs

System in packaging

Chip

One Package Module

- AP, PMIC
- Flash Memory
- **Neuromorphic**

定位

**Other OSAT**  
Conventional wire bonding packaging & Typical WLP technology

**nepes** End FAB Solution  
(Bump, WLP, FOWLP, FOPLP, SiP, TEST)

